



半导体设备国产化进程加速

1、全球及中国半导体设备市场空间 22 年创新高

ICinsights 预计 2022 年全球半导体资本开支 1817 亿美元，同比增长 19%。2023 年全球半导体设备资本开支预计 1466 亿美元，同比下降 19%。从 2000 年至今全球半导体资本开支同比增速来看，全球半导体资本开支约 3 年一个周期。2023 年处于行业周期底部，2024 年资本开支或将迎来反转。从市场空间来看，2022 年全球半导体设备市场为 1076 亿美元，中国大陆半导体设备销售额达 283 亿美元，占全球销售额 26%，为全球最大市场。从复合增速来看，2012-2022 年全球及中国半导体设备市场规模年复合增长率分别达 11%、27%，中国市场增速快于全球。

全球半导体行业资本开支



资料来源：浙商证券

2、半导体设备国产化进程或加速

预计中国大陆 2022-2026 年新增 25 座 12 寸晶圆厂，2022 年中国大陆有 23 座晶圆厂正在投产，总计月产能约 104.2 万片/月，预计 2022-2026 年新增 25 座 12 寸晶圆厂，规划月产能超过 160 万片/月，预计截至 2026 年底，中国大陆 12 寸总月产能将超过 276.3 万片，相比目前提高 165.1%。并且随着制程的提升，整体的晶圆厂资本开支强度也同步抬升。此外，半导体设备的国产化率也在逐渐提升。

全球半导体设备市场空间和市占率

图：2021 年全球半导体设备市场空间及市占率

设备类型	全球市场空间 (亿美元)	美国		日本		韩国		中国	
		公司名称	全球市占率	公司名称	全球市占率	公司名称	全球市占率	公司名称	全球市占率
刻蚀	222.8	泛林	46.0%	东京电子	29.0%				
		应用材料	16.0%						
光刻机	175.1			尼康	10.0%	阿斯麦	76.5%		
				佳能	9.9%				
Track	37.1			东京电子	89.0%			德美孚	7.0%
CVD	118.2	应用材料	27.0%	东京电子	20.0%	先晶半导体	10.0%		
		泛林	23.0%	韩国半导体	8.8%				
PVD	47.9	应用材料	86.0%						
ALD	30.6	泛林	8.6%	东京电子	29.0%	先晶半导体	45.0%		
清洗	54.2	泛林	12.0%	泛林	40.0%			德美孚	16.0%
				东京电子	25.0%				
CMP	30	应用材料	68.0%	日本瑞萨	26.0%				
				东京电子	19.0%				
热处理	29	应用材料	64.0%						
		泛林	32.0%	韩国半导体	19.0%				
离子注入	23.2	应用材料	86.0%						
ECP	9.9	泛林	78.0%						
		应用材料	17.0%						
干法去胶	8							比恩科	42.0%
量测检测	104.1	科磊	54.0%			阿斯麦	6.0%		
		应用材料	13.0%						

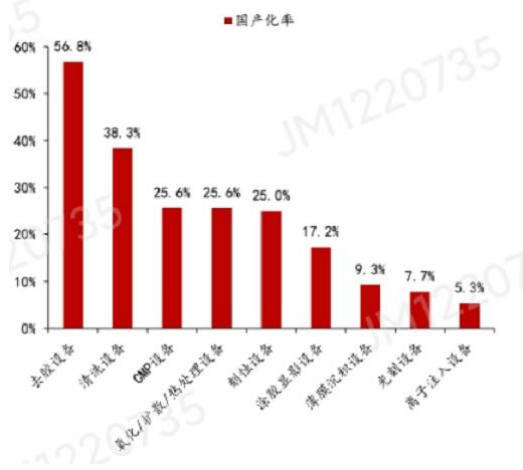
资料来源：浙商证券



3、半导体设备国产化进程加速

Openai 引爆 AI 大模型的发展时代，大模型处理的数据的增长呈现爆发式，对半导体的要求要讲提升。例如需要更高性能的处理并行数据的 GPU 作为核心处理器，还需要更高带宽的内存芯片等，对半导体的发展起到至关重要的作用。在地缘政治背景下，人工智能产业的自主可控也更为重要，其中最重要的基础设施之一就是半导体设备，目前以刻蚀、镀膜等为代表的核心半导体设备国产化率还较低，产业迎来国产化加速的良机，我们将积极关注并捕捉相关投资机会。

半导体设备国产化率估算



资料来源：浙商证券

【风险提示】

市场有风险，投资需谨慎。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金管理人提醒投资者在做出投资决策前应全面了解基金的产品特性并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，投资者自行承担基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险。投资有风险，选择须谨慎。敬请投资者于投资前认真阅读基金的基金合同、最新招募说明书、基金产品资料概要及其他法律文件。

本材料为客户服务材料，不构成任何投资建议或承诺，本材料并非基金宣传推介材料，亦不构成任何法律文件。若本材料转载或引用第三方报告或资料，转载内容仅代表该第三方观点，并不代表兴合基金的立场。